

	2009 4 15		
	7,799		
	536		
	29.68%	24.62%	54.30%
			2017 3 31
	C29		871218
			2019 8
			23
	2021 12	2023 1	
	3	/	

	2023 6 30		
	“ ”		
	“ ”		
	“ ”		

2023 6			
2023 9			

2023 10 2023 11			

（本页无正文，为《关于杭州本松新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）



中国国际金融股份有限公司（签章）

2023年6月30日